

第 80 期

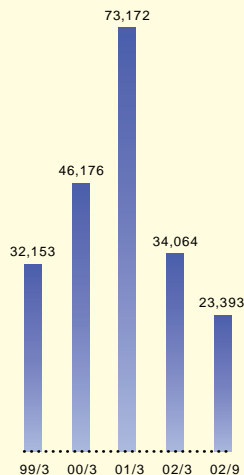
中間事業報告書



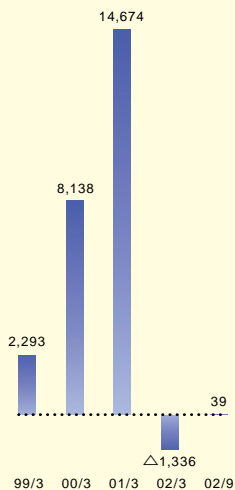
株式会社東京精密

財務ハイライト

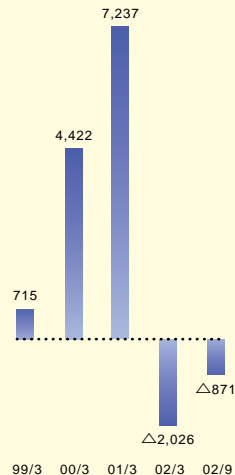
連結売上高(百万円)



連結経常損益(百万円)



連結当期(中間)損益(百万円)



単位:百万円

	1999/3	2000/3	2001/3	2002/3	2002/9 (中間期)
連結売上高	32,153	46,176	73,172	34,064	23,393
連結経常損益	2,293	8,138	14,674	1,336	39
連結当期(中間)損益	715	4,422	7,237	2,026	871
連結総資産	41,309	61,007	91,477	79,865	85,775
連結純資産	28,437	33,433	38,779	35,423	33,652
発行済株式総数(千株)	37,004	37,543	37,465	37,372	37,372
1株当たり連結当期(中間)損益(円)	19.41	118.43	192.95	54.21	23.31

1株当たり連結当期(中間)損益は、期中の平均株式数により算出しています。

見通しに関する注意事項

この事業報告書に掲載されている東京精密の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実ではない事柄は、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。リスクや不確実性には、世界経済の動向、当社の事業領域の市況、為替変動、急速な技術革新による競争の激化などがあります。このような事象により、実際の業績はこれら見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。

株主の皆様へ

東京精密の株式を保有して頂き、有難う存じます。厚く御礼申し上げます。

さて、当社は、株主の皆様が当社株式を保有していただいた目的に沿った経営を目指しております。

当社は、経営指標といたしましては、一株当たりの純利益(EPS)を長期的に増大させていく事を重視しております。これは当社のモットーであるWIN-WINの関係を株主の皆様と会社との間で作り上げる事につながると確信しております。

当社は、技術指向型の会社です。上記の目的のために当社は次の「製品開発の原則」に沿って技術開発を継続的に行ってまいります。

1. 世界No. 1の製品を創る。

マーケットシェアNo. 1の商品は

(1) 好況時は、利益の極大化を図れる。

(2) 不況時は、損失の極小化を図れる。

2. 研究開発投資は自己資金で。

3. 今後の開発は技術障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う。

4. 相応しいパートナーを見つけ、開発コストをシェアするとともに開発の成果を共有する。

この原則を守るためには、各国、各社の持つ異文化を包摂したグローバルかつハイブリッドな東京精密の文化風土を醸成しなければなりません。そこで、「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」というモットーを制定し、世界No.1の商品開発体制の構築に努めてまいりました。

さらに、昨年1月には「ACCRETECH(アクレーテック)」というコーポレートブランドを導入しました。「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して、世界No.1の商品を創り、皆様と共に大きく成長していく」という当社の企業理念を表したものです。

株主の皆様にも是非当社の企業理念にご賛同賜り、このコーポレートブランド「ACCRETECH」のもと、更なる飛躍を目指す当社に、今後とも格別なるご理解とご支援をお願い申し上げます。



代表取締役社長

大坪英夫

QUESTION 1. 東京精密が製造販売する製品市場について教えてください。

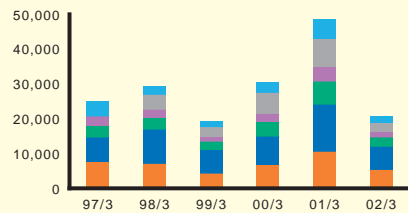
ANSWER. ご存知のとおり、当社は半導体製造装置と計測機器の製造・販売を事業の二本柱としています。この二つの製品市場は、企業の設備投資の影響を受けるという点では共通していますが、景気変動の度合いと中長期での成長性に違いがあります。

半導体製造装置市場は、技術革新の速い半導体製品のライフサイクルの影響を受けます。新世代の半導体製品は、市場に登場後しばらくは価格が上昇するものの、生産拡大に伴い供給過剰となり、やがて価格の下落が訪れるという半導体産業の景気循環、いわゆるシリコンサイクルと呼ばれる比較的激しい景気変動があります。この変動は、当社の業績にも大きく影響を及ぼすことは否めませんが、当社は市況の変動に迅速に対応する生産方式を構築するなど、景気が悪い時期でも損失を最小限に抑える体制を構築しています。

一方、計測機器業界は一般的な景気動向に左右される業界であり、大幅な景気変動の少ない市場です。当社の計測機器事業は、常にお客様のニーズに合った製品を供給することで、近年は、比較的安定した事業となっています。

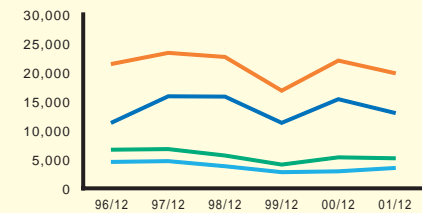
変動が激しい半導体製造装置事業は、昨年度は、シリコンサイクルの落ち込みに世界的な不況と米国でのテロ事件の影響等が重なり、過去に例をみない深い谷を経験しました。今年度は、春先よりDVDやLCDドライバー、携帯機器関連、ゲーム等の需要が伸び、受注は大幅に増加しました。しかし、8月頃から受注は伸び悩み、前年比では引き続き大幅成長を記録するものの、本格的な市況の回復は、当初10月頃からと見られていましたが、やや先送りとなっています。PC等の半導体の最終製品の需要動向の予測が困難な状況の下、製造装置の納期も年々短縮され、半導体市況の回復時期は誰もが予想しにくい状況であるのが現状です。しかし、中長期的な視野に立つと、情報家電を中心としたデジタル家電製品の拡大が期待され、半導体製造装置市場は依然、成長産業と位置付けられます。

世界の半導体製造装置販売高推移 (台数)



■ その他
■ 台湾
■ 韓国
■ 欧州
■ 北米
■ 日本

工作機械生産台数 (台数)



■ 旋盤
■ 研削盤
■ マシニングセンタ
■ 専用機

QUESTION 2. 東京精密の事業戦略および将来の見通しを教えてください。

ANSWER. 当社は、成長市場に経営資源を集中させることにより、高成長・高収益な会社を目指しています。具体的には、当社の経営指針である「製品開発の原則」に則り、半導体製造装置市場で、技術参入障壁が高く市場が大きく、ニーズも高い分野の製品開発に近年積極的に取り組んできました。

また当社は、「半導体業界に貢献する最先端の製品」「スピーディかつ効率の良い開発」を心掛けているため、WIN-WINの関係をベースに、優秀な技術を持つ会社及び個人とのアライアンスを積極的に行うことにより、市場ニーズを満たす製品の短期開発を実現しています。

その成果として、2000年度以降3つの新製品を市場に投入しました。半導体生産の歩留まり向上に貢献するウェーハ外観検査装置、半導体デバイスの薄片化・小型化・大容量化に貢献するポリッシュグラインダ、半導体デバイスの微細化・高密度化・多層配線化等に不可欠でウェーハ表面を平坦化するCMPがそれです。来年度には、半導体デバイスの微細化・高集積化の中核技術で最も大きな技術的・経済的ブレークスルーの実現が期待されている次世代リソグラフィ装置「LEEPL」を市場投入する予定です。

これら新製品群の売上高は、2000年度より着実に増加しており、今年度は、約100億円近く見込まれています。これは、計測製品の売上高にほぼ匹敵する額です。新製品群の売上は今後更に拡大し、当社業績に大いに貢献していくと期待されています。



ウェーハ外観検査装置
[WIN-WIN 50]



ポリッシュグラインダ
[PG300RM]



CMP装置
[A-FP-310A]



リソグラフィ装置
[LEEPL・量産機]
(完成予想イラスト)

新製品情報

ウェーハ外観検査装置「HA3000」

半導体デバイスの微細化が益々進化する中、当社は、デザインノード90ナノメートル以降の半導体プロセスに対応した次世代ウェーハ外観検査装置「HA3000」を(株)日立ハイテクノロジーズと共同開発し、7月に米国で開催されたセミコンウエスト(半導体製造装置の展示会)で発表しました。「HA3000」は、両社が得意とする先端技術を集約した成果であり、遠紫外光の採用により微細欠陥の検出が可能となりました。また、世界最速の画像処理装置を搭載したことにより、従来装置の数倍以上の高速化を実現し、生産性の高い装置として期待されています。



ウェーハプロ - ビングマシン「UF3000」

世界No.1のウェーハプロ - ビングマシンメーカーである当社は、300mmウェーハ対応としては第3世代となる超高性能な「UF3000」を開発し、2002年度下期より市場投入しました。精度の向上に飛躍的に貢献する当社独自の最新位置決め技術(OTC)、半導体チップのマルチ測定に不可欠な超高剛性チャック(QPU)など、当社の独創的な技術を融合した装置です。制御系全般も改良し、次世代に対応できるプラットフォームとして進化しました。300mmウェーハでの半導体デバイス量産時に最適な装置として、マーケットシェアの更なる拡大を目指します。

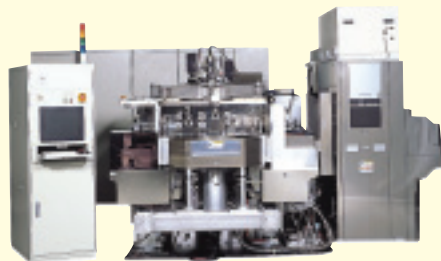


新しいタイプの「レーザーダイサー」

当社は、今後急速な普及が期待される極めて薄い150 μ m以下のウェーハの切断を可能にする画期的なダイサーを12月4日～6日の半導体製造装置展示会「セミコンジャパン」で発表し、来年第2四半期より市場投入します。この製品は、浜松ホトニクス(株)と共同開発するもので、従来のダイヤモンドブレードの代わりにレーザーを使用した新しいタイプのダイサーで、ウェーハ表面に損傷を与えず内部に形成した改質層を垂直に成長させてチップの分割を行います。ブレードダイサーの数倍以上の高速切断、切削幅がほとんど無いためウェーハ1枚当たりのチップ数の大幅な向上、さらに完全ドライプロセスのため洗浄が不要等の特長とする革新的な装置で、ダイシングプロセスのコスト削減が可能となります。

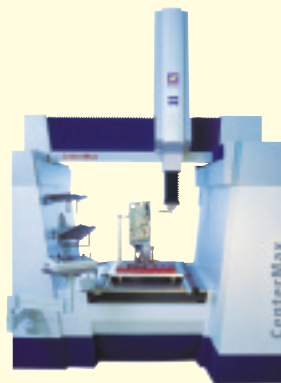
リソグラフィ装置「LEEPL」

LEEPLは、高い技術障壁と装置の高コスト化という次世代リソグラフィ装置の課題を解決する画期的な技術として注目されています。半導体デバイスメーカーでの 機 リソグラフィ装置としての要素を全て備えたフルファンクションの試作機 の評価では、アライメント、解像度、スループット等、必要とされる基本性能をクリアしました。現在、当社及び(株)リープルは、来春の市場投入を目指し、量産機を開発中です。次世代装置としての用途に留まらず、KrF及びArFなど既存の半導体生産ラインでの使用も真剣に検討されています。



高精度CNC三次元座標測定機「CenterMax」

一般的な三次元座標測定機は使用温度を管理した専用の検査室が必要ですが、「CenterMax」は、耐環境性を飛躍的に向上させ、生産現場(15~35℃)での高精度かつリアルタイムでの測定を実現させた画期的な装置です。当社の計測事業分野で提携しているドイツのCarl Zeiss社製の製品で、欧米ではすでに市場投入され、大手自動車メーカーを始め多くのお客様から高く評価されている装置です。これからの日本市場での普及が大いに期待されます。



高精度真円度測定機「RONDCOM 65A」+ CNC検出器ホルダー

世界最高の回転精度と測定速度を誇る「RONDCOM 65A」用に新たにCNC検出器ホルダーを開発しました。従来は、測定者が測定箇所へ検出器の向きを合わせていましたが、このCNC検出器ホルダーを装備すると、内径/外径/上面/下面/テーパー面と全ての向きで測定者の手を煩わすことなく、全自動測定が可能になります。その結果、測定者による設定誤差が無くなると同時に測定時間が短縮できます。お客様からも大変好評で、今後は、他の真円度測定機へ展開していく予定です。



営業の概況

1. 当中間期の概況

業績全般

当中間期の半導体業界は、春先以降市況の回復が見られましたが、その後、世界的に景気の回復が遅れるなか、先行きに対して不透明感が増しております。DVDやデジタルカメラなどは、好調に推移しておりますが、パソコンや携帯電話などが伸び悩んでおり、国内外の半導体メーカーの設備投資姿勢は慎重なものとなっております。

計測機器部門も、アジア・中国地域の需要は比較的堅調でありましたが、国内は依然として各ユーザーの設備投資は低調でありました。

このような状況下、当社の連結売上高は、半導体既存製品と半導体新製品の売上伸長により、233億93百万円(前年同期比19.9%増)と増収になりました。経常利益は、前期の操業度低下による原価高等の要因で黒字幅が縮小し39百万円となりました。また、株式評価損及び半導体既存製品の機種変更に伴う経費の集中発生等の特別損失計上により当中間期損失8億71百万円を余儀なくされました。

各部門の概況

[半導体製造用機器部門]

当社は、台湾、韓国および米国地域等における期前半の堅調な設備投資需要をはじめ、半導体メーカーのニーズを的確に捉え、緻密な営業を展開する一方、固定費削減などのコストダウン策を推進いたしました。そ

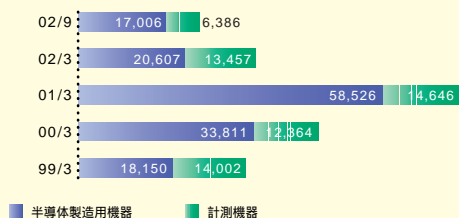
の結果、半導体部門の売上高は、ウェーハプロ - ビングマシン、ウェーハダイシングマシンなど既存製品の売上回復と、ウェーハ外観検査装置、ポリッシュグラインダなど新製品の売上伸長により、170億6百万円(前年同期比36.5%増)となりました。

主力商品のウェーハプロ - ビングマシンでは、300mm対応の高剛性を特徴とする最新鋭機種「UF300A」が、お客様から高い支持を得て順調に販売が伸びています。ウェーハダイシングマシンにつきましても、300mm対応の「A-WD-300T」が生産性の高いマシンとして機能を高く評価され、売上が伸長しております。ウェーハ外観検査装置では、「WIN-WIN501200」を新しく発売し、高感度、高スループットのマシンとして評価が高く、売上が伸びています。ポリッシュグラインダ「PG200」「PG300」も顧客層を拡大しており、隣接工程をインテグレ - トしたRMタイプも需要が増加しています。また、CMP装置「A-FP-210A」につきましても、上期に既に受注を受け、2002年度下期より、売上計上が見込まれます。

研究開発につきましては、300mmウェーハへの移行や微細化が進展するなかで、300mm対応機種をはじめ、市場ニーズに適合する次世代装置のタイムリーな開発に注力しております。ウェーハプロ - ビングマシンでは、次世代デバイスの微細化や多様なテスト環境に対応できる、超高性能の300mm対応機種「UF3000」を開発し、この下期より販売を開始しました。ウェーハ外観検査装置につきましては、「WIN-WIN501200」の新発売に加え、本年7月には、当社と株式会社日立ハイテクノロジーズが共同開発した、90nmノード以降に対応できるウェーハ外観検査装置「HA-3000」を発売し、市場投入しました。CMP装置では、300mm対応の「A-FP-310A」の販売を開始し、お客様の多様なプロセス性能の要求に応えてまいります。

子会社の株式会社リープルが進めている100nm ~ 35nmの微細回路製造用リソグラフィ装置「LEEPL」の開発は順調に進んでいます。昨年6月に、当社、株式会社リープル、ソニー株式会社の3社が、次世代リソグ

連結部門別売上高(百万円)



ラフィ技術の開発促進並びに普及を目的にして、各業界に呼びかけて、「LEEPL技術コンソーシアム」を発足させました。当初、半導体デバイスメーカー、装置メーカー、マスクメーカー、レジストメーカー合わせて13社で発足しましたが、その後加入企業が増加し、現在では28社が活動しています。「LEEPL」リソグラフィ装置は、次世代リソグラフィの本命として脚光を浴びておりますが、今後、コンソーシアムを中心に開発が一層加速され、リープル事業が当社のコア事業に成長していくものと予想されます。また、当社は、LEEPL技術の開発・促進に必要な「電子ビームマスク欠陥検査装置」の開発も、計画どおり進めています。

[計測機器部門]

当社は、ユーザーニーズを確実に受注に取込む営業努力を行い、生産面でも固定費の圧縮に努めましたが、主要ユーザーの自動車業界や工作機械業界の設備投資抑制の影響を受け、売上高は、63億86百万円(前期比9.4%減)となりました。汎用計測機器では、世界最高精度を誇る表面粗さ測定機「サーフコム3000A」や高精度で好評の真円度測定機「ロンコムシリーズ」の売上が堅調に推移しました。また、ドイツのカール・ツァイス社と提携し、高品質で定評のある三次元座標測定機の売上が前年比伸長しています。自動計測機器では、「パルコムシリーズ」が流体軸受向けなどに好調に推移しました。

研究開発につきましては、ユーザーからの要望が強くなっている高速、高精度、高機能などの要請に応えるべく、表面粗さ測定機、真円度測定機などにおいて、高付加価値かつ操作性の高い製品の開発を進めています。また、三次元座標測定機では、生産現場環境下で高精度測定を実現した高精度三次元座標測定機「CenterMax」を新発売し、今後拡販が期待されます。

東精精密設備(上海)有限公司の設立と営業開始

当社は、中国現地法人「東精精密設備(上海)有限公司」を設立し、10月より営業を開始しました。同現地法



東精精密設備開所式

人は、上海に設立した当社100%出資の子会社で、保税区内に物流拠点も保有しています。中国国内における半導体製造用機器および計測機器の販売から物流、据付、保守までの業務を一貫して行い、東京精密グループの中国におけるサポート体制を強化します。

当社は、1960年代より、合併会社「三门峡中原精密有限公司」を設立し、計測機器の生産・販売を行うなど、40年に亘り、中国市場とは密接な関係を築いておりますが、近年の中国における半導体産業の急成長に伴い、本現地法人を設立し、半導体製造用機器につきましても、顧客ニーズへの対応力を大幅に強化するものです。

自動計測機器部門の営業譲渡

当社は、自動計測機器部門を子会社である東精エンジニアリングに譲渡する方針を決定しました。中国市場の機械加工分野においても、自動計測機器の需要が急増しており、同部門を東精エンジニアリングに集中、製品戦略も含め、きめ細かな事業展開を進めていきます。東京精密は、予てより自動計測機器部門の市場規模が比較的小さいこともあり、連結子会社東精エンジニアリングへの営業譲渡を検討してきました。同社は既に国内外で自動選別機等、一部の自動計測機器を取り扱っており、また中国国内において、自動計測器全般の販売を手掛けています。

このような状況下、中国を中心とするアジア市場の拡大に対して、東精エンジニアリングが一元的に対応

することとし、営業譲渡の方針を決定したものです。なお、日本国内での自動計測機器部門の販売は、当社が委託を受けることとしており、国内の取引先への対応は現状通りとなります。営業譲渡により、東京精密の個別決算では、特別利益の計上が見込まれます。

利益配分について

当中間期の配当につきましては、引続き厳しい状況下ではありますが、下記理由から当初予想のとおり15円とすることといたしました。

- A. 半導体産業は、市況の急伸・急落があるので短期の業績を直ちに配当に反映させることは、長期的視点で保有していただいている株主の皆様の視点と合致しないこと。
- B. 当社の財務状況と今後のキャッシュ・フロー、及び平成14年9月末末処分利益76億12百万円から年間30円配当継続には無理のないこと。

2. 通期の見通し

平成2002年度下期につきましては、米国経済をはじめとして不透明感が増しており、内外の半導体メーカーも慎重な設備投資姿勢を継続するものと予想されます。このような状況下、当社は、半導体部門の下期の市況は期初予想比伸び悩むと考え、既存主力製品の売上高は上期実績対比10%強の減収を見込みました。しかしながら、ウェーハ外観検査装置、ポリッシュングラインダなどの新製品売上高が、上期比倍以上に伸長することにより、半導体部門の下期売上高は、上期比約18%増を予定しています。

半導体新製品の売上高は、通期では約100億円が見込まれ、半導体製造用機器部門の2002年度の売上高は、370億円(前期比79.6%増)を予想しております。半導体の下期の利益につきましては、上期の原価高要因がなくなることから、上期比改善となり、相応の利益が確保できる見込です。

計測機器部門につきましては、国内全般景況の回復は緩やかで、自動車および工作機械メーカーをはじめ

とする各ユーザーの設備投資抑制が続くものと考えられます。かかる状況下、ユーザーニーズを受注に繋げ拡販に努めるとともに、需要が比較的堅調なアジア、中国地域での売上増強などにより、2002年度の売上高は、130億円(前期比3.4%減)を予定しています。

以上のような予測の下、2002年度の連結売上高は500億円(前年同期比46.8%増)、連結経常利益は15億円と予想しています。また、連結当期利益は、個別決算で計上される営業譲渡益が消去される為、2億円と予想しております。

期末配当金につきましては、上記業績見通し及び当社の利益配分に関する基本方針に従い、安定的な配当を継続することとし、当初予想どおり15円(中間配当金15円と合わせ通期では1株につき30円)を予定しております。

3. 財政状態

当中間期末における現金及び現金同等物は、前期末より4億円増加し63億円となりました。当中間期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは17百万円の減少となりました。これは主に、税引前損失(12億円)、売上債権の増加(42億円)、減価償却費(9億円)および仕入債務の増加(46億円)などによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、11億円の減少となりました。これは当社および連結子会社による設備投資支出(11億円)によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、14億円の増加となりました。これは主に、長期借入金の実行(50億円)、短期借入金の返済(28億円)および配当金(5億円)等によるものです。

当中間期の営業キャッシュ・フローは、前年同期に比べ94億円改善されていますが、当社は、今年度新製品の売上拡大や利益計上などにより、営業キャッシュ・フローの更なる好転が見込まれ、投資活動も平準化することから、より良い財務状況を構築できる見込です。

中間連結貸借対照表

単位：千円

科 目	前連結会計年度末 (02.03.31)	当中間連結会計期間末 (02.09.30)
	金額	金額
流動資産	53,234,688	57,550,129
現金及び預金	5,924,839	6,334,143
受取手形及び売掛金	12,156,017	16,268,096
たな卸資産	34,127,962	33,816,956
未収消費税等	104,664	224,947
繰延税金資産	298,553	311,725
その他	658,853	639,462
貸倒引当金	36,203	45,201
固定資産	26,630,548	28,224,791
(有形固定資産)	(13,849,018)	(15,429,265)
建物及び構築物	6,041,340	6,020,690
機械装置及び運搬具	3,223,439	2,946,119
工具器具備品	823,470	761,886
土地	2,916,779	2,916,779
建設仮勘定	843,988	2,783,790
(無形固定資産)	(6,358,475)	(6,257,347)
ソフトウェア	6,200,391	5,790,606
連結調整勘定	-	280,237
その他	158,084	186,503
(投資その他の資産)	(6,423,055)	(6,538,178)
投資有価証券	2,853,440	2,104,203
長期貸付金	100,442	83,496
繰延税金資産	2,858,359	3,777,230
その他	702,125	643,501
貸倒引当金	91,313	70,253
繰延資産	125	109
社債発行差金	125	109
資産合計	79,865,363	85,775,031

科 目	前連結会計年度末 (02.03.31)	当中間連結会計期間末 (02.09.30)
	金額	金額
流動負債	31,227,779	36,125,537
支払手形及び買掛金	5,242,271	9,561,625
短期借入金	22,815,711	19,938,549
一年以内に返済する長期借入金	264,140	2,452,478
未払法人税等	296,001	480,099
賞与引当金	608,371	606,492
その他	2,001,283	3,086,293
固定負債	11,448,964	14,182,543
社債	250,000	250,000
転換社債	51,000	51,000
長期借入金	7,765,010	10,420,670
退職給付引当金	2,794,371	2,931,398
役員退職慰労引当金	540,852	477,083
繰延税金負債	47,729	52,391
負債合計	42,676,743	50,308,081
少数株主持分	1,764,889	1,814,449
資本		
資本金	7,199,991	7,199,991
資本準備金	11,806,740	
連結剰余金	16,463,548	
資本剰余金		11,806,740
利益剰余金		14,806,526
その他有価証券評価差額金	244,060	292,397
為替換算調整勘定	208,331	145,230
自己株式	10,822	13,591
資本合計	35,423,729	33,652,499
負債、少数株主持分及び資本合計	79,865,363	85,775,031

中間連結損益計算書

単位:千円

科 目	前中間連結会計期間(01.04.01-01.09.30)		当中間連結会計期間(02.04.01-02.09.30)	
	内 訳	合 計	内 訳	合 計
I 売上高		19,506,579		23,393,504
II 売上原価		13,245,390		18,101,300
売上総利益		6,261,189		5,292,203
III 販売費及び一般管理費				
販売費	4,000,897		3,743,995	
一般管理費	1,546,372	5,547,269	1,163,257	4,907,252
営業利益		713,919		384,951
IV 営業外収益				
受取利息	18,069		3,522	
受取配当金	92,667		12,588	
その他	174,107	284,844	66,540	82,651
V 営業外費用				
支払利息	107,342		132,645	
その他	126,298	233,641	295,071	427,716
経常利益		765,123		39,886
VI 特別利益				
連結子会社株式売却益	1,902,046	1,902,046	-	-
VII 特別損失				
たな卸資産評価損及び廃却損	829,438		903,700	
その他	381,842	1,211,281	359,724	1,263,425
税金等調整前中間純利益(損失)		1,455,888		1,223,538
法人税、住民税及び事業税	434,328		369,969	
法人税等調整額	396,910	831,238	842,910	472,941
少数株主利益		91,395		120,474
連結中間純利益(損失)		533,254		871,071

中間連結剰余金計算書

単位:千円

科 目	前中間連結会計期間(01.04.01~01.09.30)		当中間連結会計期間(02.04.01~02.09.30)	
	内 訳	合 計	内 訳	合 計
I 連結剰余金期首残高		20,401,599		
II 連結剰余金減少高				
1.配当金	561,985			
2.取締役賞与金	64,890			
3.自己株式消却額	726,033	1,352,908		
III 中間純利益		533,254		
IV 連結剰余金中間期末残高		19,581,945		
(資本剰余金の部)				
I 資本剰余金期首残高				
資本準備金期首残高			11,806,740	11,806,740
II 資本剰余金増加高			-	-
III 資本剰余金減少高			-	-
IV 資本剰余金中間期末残高				11,806,740
(利益剰余金の部)				
I 利益剰余金期首残高				
連結剰余金期首残高			16,463,548	16,463,548
II 利益剰余金増加高			-	-
III 利益剰余金減少高				
1.中間純損失			871,071	
2.配当金			560,559	
3.取締役賞与金			12,816	
4.連結子会社増加による利益剰余金減少高			212,575	1,657,022
IV 利益剰余金中間期末残高				14,806,526

中間連結キャッシュ・フロー計算書

単位：千円

科 目	前中間連結会計期間 (01.04.01 - 01.09.30)	当中間連結会計期間 (02.04.01 - 02.09.30)	科 目	前中間連結会計期間 (01.04.01 - 01.09.30)	当中間連結会計期間 (02.04.01 - 02.09.30)
	金額	金額		金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益 (損失)	1,455,888	1,223,538	定期預金の預入による支出	187,004	10,000
減価償却費	886,930	952,681	定期預金の払出による収入	150,000	10,000
連結調整勘定償却額	-	40,033	有価証券・投資有価証券の取得による支出	203,097	678
退職給付引当金の増加額	58,596	137,026	関係会社有価証券・出資金の取得による支出	4,706	25,710
役員退職慰労引当金の増減額	99,687	63,769	連結子会社株式の売却による収入	1,861,200	-
受取利息及び受取配当金	110,736	16,111	有形・無形固定資産の取得による支出	4,250,862	1,114,223
支払利息	130,698	132,645	有形固定資産の売却による収入	5,218	2,100
連結子会社株式売却益	1,902,046	-	貸付金の回収による収入	34,169	16,946
有形固定資産除却・売却損	4,816	2,045	投資活動によるキャッシュ・フロー	2,595,083	1,121,564
有価証券・ゴルフ会員権評価損	355,379	170,444	III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
たな卸資産評価損及び廃却損	829,438	903,700	短期借入金増減額(純額)	8,588,200	2,861,186
売上債権の増減額	10,476,921	4,266,749	長期借入れによる収入	1,400,000	5,000,000
たな卸資産の増加額	5,164,652	814,242	長期借入金の返済による支出	131,048	156,002
販売用ソフトウェアの減少額	206,094	274,668	連結子会社の増資による収入	1,353,600	-
仕入債務の増減額	11,217,922	4,615,696	自己株式の消却による支出	726,033	-
取締役賞与の支払額	64,890	12,816	配当金の支払による支出	561,985	560,559
その他営業活動による支出	591,930	558,219	その他財務活動による収入(支出)	96	7,953
小計	4,547,728	273,494	財務活動によるキャッシュ・フロー	9,922,636	1,414,299
利息及び配当金受取額	31,241	16,111	IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	23,297	8,737
利息の支払額	141,324	116,441	V 現金及び現金同等物の増減額	2,139,101	283,566
法人税等の支払額	4,785,545	191,070	VI 現金及び現金同等物の期首残高	6,785,863	5,897,839
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,443,356	17,905	連結子会社増加に伴う期首残高増加額	-	125,737
			VII 現金及び現金同等物期末残高	4,646,762	6,307,143

中間貸借対照表(単独決算)

単位:千円

科 目	前会計年度末 (02.03.31)	当中間会計期間末 (02.09.30)	科 目	前会計年度末 (02.03.31)	当中間会計期間末 (02.09.30)
	金額	金額		金額	金額
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	48,068,340	52,434,797	流動負債	30,477,759	35,082,570
現金及び預金	3,946,931	4,040,110	支払手形	4,731,659	6,961,399
受取手形	681,015	1,062,072	買掛金	1,868,040	3,906,960
売掛金	12,854,348	16,031,710	一年以内償還予定社債	—	2,400,000
たな卸資産	26,392,457	26,097,827	短期借入金	22,000,000	19,500,000
未収消費税等	143,542	230,623	未払金	566,942	916,665
繰延税金資産	201,828	252,970	未払法人税等	20,410	20,376
その他	3,854,695	4,735,945	賞与引当金	400,050	413,879
貸倒引当金	6,479	16,462	その他	890,657	963,289
固定資産	26,054,432	27,213,875	固定負債	9,900,797	12,523,917
(有形固定資産)	(9,608,531)	(9,343,072)	社債	7,200,000	4,800,000
建物及び構築物	4,355,114	4,342,101	転換社債	51,000	51,000
機械装置	2,377,652	2,163,842	長期借入金	—	5,000,000
土地	1,528,421	1,528,421	退職給付引当金	2,176,496	2,306,402
その他	618,388	576,677	役員退職慰労引当金	473,301	366,515
建設仮勘定	728,954	732,029	負債合計	40,378,557	47,606,488
(無形固定資産)	(6,233,956)	(5,815,678)	(資本の部)		
ソフトウェア	6,190,439	5,776,806	資本金	7,199,991	7,199,991
その他	43,517	38,872	法定準備金	12,535,295	
(投資等)	(10,211,943)	(12,055,123)	資本準備金	11,806,740	
投資有価証券	2,273,846	2,019,350	利益準備金	728,554	
子会社株式	3,877,046	3,877,046	剰余金	14,264,765	
長期貸付金	887,317	2,171,281	任意積立金	5,000,000	
繰延税金資産	2,656,786	3,505,665	当期末処分利益	9,264,765	
その他	597,225	547,505	(うち当期純損失)	(1,850,023)	
貸倒引当金	80,278	65,725	資本剰余金		11,806,740
繰延資産	8,000	4,000	資本準備金		11,806,740
社債発行差金	8,000	4,000	利益剰余金		13,341,483
資産合計	74,130,772	79,652,672	利益準備金		728,554
			任意積立金		5,000,000
			中間未処分利益		7,612,928
			(うち中間純損失)		(1,091,276)
			その他有価証券評価差額金	237,014	288,439
			自己株式	10,822	13,591
			資本合計	33,752,215	32,046,184
			負債及び資本合計	74,130,772	79,652,672

(注) 1. 子会社に対する短期金銭債権	5,437,411千円	6,646,582千円	6. 自己株式数	2,350株	3,158株
2. 子会社に対する短期金銭債務	2,800,926千円	3,244,369千円	7. 有形固定資産の減価償却累計額	7,581,161千円	8,082,405千円
3. 子会社に対する長期金銭債権	824,075千円	2,112,800千円	8. 債務保証及び保証類似行為	407,950千円	349,500千円
4. 子会社に対する長期金銭債務	7,200,000千円	7,200,000千円	9. 受取手形割引高	2,229,766千円	2,557,456千円
5. 主な外貨建資産			10. 役員退職慰労引当金は商法第287条/2の引当金であります。		
売掛金	3,568,532千円	4,374,049千円			
子会社株式	2,500,996千円	2,500,996千円			

中間損益計算書(単独決算)

単位: 千円

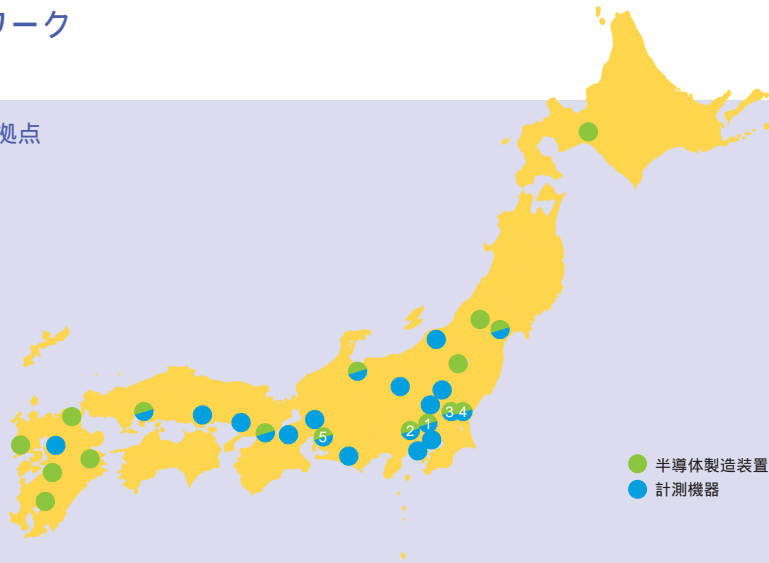
科 目	前中間連結会計期間(01.04.01 - 01.09.30)		当中間連結会計期間(02.04.01 - 02.09.30)	
	内 訳	合 計	内 訳	合 計
I 売上高		16,175,441		19,549,886
II 売上原価		12,389,770		16,835,601
売上総利益		3,785,671		2,714,284
III 販売費及び一般管理費				
販売費	2,592,658		2,457,239	
一般管理費	1,089,514	3,682,173	693,944	3,151,184
営業利益(損失)		103,498		436,899
IV 営業外収益				
受取利息及び配当金	442,084		182,655	
その他	7,585	449,670	7,241	189,897
V 営業外費用				
支払利息	121,019		156,283	
その他	166,179	287,199	270,564	426,847
経常利益(損失)		265,969		673,849
VI 特別利益				
子会社株式売却益	1,793,737	1,793,737	-	-
VII 特別損失				
たな卸資産評価損及び廃却損	829,438		903,700	
その他	374,218	1,203,656	355,714	1,259,414
税引前中間純利益(損失)		856,049		1,933,264
法人税、住民税及び事業税	41,127		20,717	
法人税等調整額	314,860	355,987	862,705	841,987
中間純利益(損失)		500,062		1,091,276
前期繰越利益		12,399,927		8,704,205
自己株式消却額		726,033		-
中間未処分利益		12,173,956		7,612,928

(注) 子会社との取引高

1. 売上高	3,189,547千円	3,675,696千円
2. 仕入高	5,872,436千円	3,781,933千円
3. 営業取引以外の取引高	62,585千円	92,527千円

ネットワーク

国内主要拠点



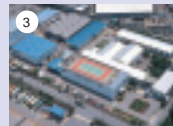
- 半導体製造装置
- 計測機器



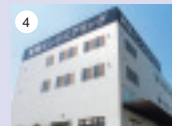
1 本社(業務会社)



2 八王子工場(半導体社)
株式会社アクレテック・マイクロテクノロジー



3 土浦工場(計測社)

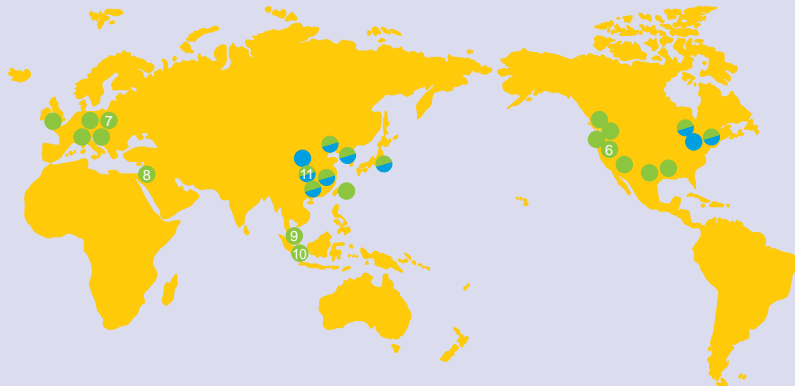


4 ㈱東精エンジニアリング
本社・工場



5 ㈱東精エンジニアリング
名古屋工場

海外拠点



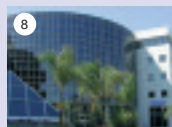
- 半導体製造装置
- 計測機器



6 Accretech USA, Inc.



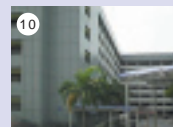
7 Tokyo Seimitsu
Europe GmbH



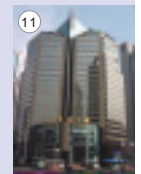
8 Accretech
(Israel) Ltd.



9 Accretech
(Malaysia) Sdn. Bhd.



10 Accretech
(Singapore) Pte. Ltd.

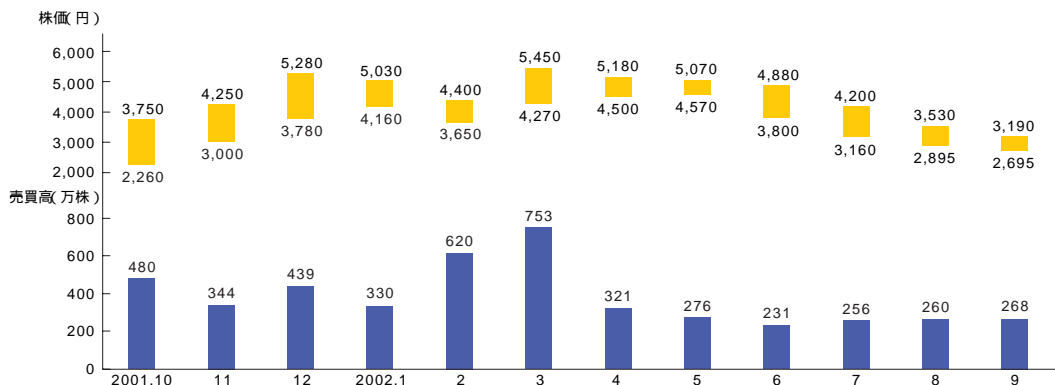


11 東精精密設備
(上海)有限公司

会社の概況 (平成14年9月30日現在)

商号	株式会社 東京精密 (TOKYO SEIMITSU CO., LTD.)	事業所	業務会社 東京都三鷹市 半導体社 東京都八王子市 計測社 茨城県土浦市
設立	昭和24年3月28日	営業所	東北(宮城県仙台市) 長野(長野県岡谷市) 山形(山形県山形市) 浜松(静岡県浜松市) 茨城(茨城県土浦市) 名古屋(愛知県三好町) 宇都宮(栃木県宇都宮市) 小牧(愛知県西春町) 埼玉(埼玉県さいたま市) 京滋(滋賀県守山市) 東京(東京都三鷹市) 大阪(大阪府吹田市) 販売 一課、二課、三課 加古川(兵庫県加古川市) (東京都八王子市) 岡山(岡山県岡山市) 西東京(東京都八王子市) 広島(広島県広島市) 川崎(神奈川県川崎市) 広島(広島県福山市) 新潟(新潟県分水町) 九州(福岡県久留米市) 厚木(神奈川県厚木市) 九州(大分県大分市) 北陸(富山県富山市)
証券取引所	東京証券取引所 市場第一部	国内子会社	(注) :全製品取扱 :半導体製品取扱 無印:計測・自動計測製品取扱 株式会社 東精工エンジニアリング 株式会社 アクレーテック・マイクロテクノロジー 株式会社 トーセシステムズ 株式会社 東精クリエイト 株式会社 アクレーテック・ファイナンス 株式会社 リーブル 株式会社 東精ボックス
役員	代表取締役会長兼社長 Chairman & C.E.O. 大坪 英夫 代表取締役 海外事業担当 鴻田 道明 代表取締役 C.O.O. 半導体社担当 鈴木 貞勝 代表取締役 C.T.O. 企画担当 薦 清昭 代表取締役 C.O.O. 業務会社担当 西嶋 尚生 取締役 高城 英明 取締役 林 和博 取締役 藤森 一雄 取締役 太田 邦正 取締役 ウォルフガング・ポナッツ 監査役(常勤) 軽部 昭三郎 監査役 坂田 耕四郎 監査役 小倉 利之 監査役 野口 光	海外子会社	Accretech USA, Inc. Tokyo Seimitsu Europe GmbH Accretech (Malaysia) Sdn. Bhd. Accretech (Israel) Ltd. Accretech (Singapore) Pte. Ltd. Accretech MICRO TECHNOLOGIES KOREA CO., LTD 東精精密設備(上海)有限公司
従業員数	652名	海外関連会社	三門峡中原精密有責任公司
主要取引銀行	みずほコーポレート銀行 大手町営業第二部 UFJ信託銀行 東京第一営業部 三井住友銀行 本店法人営業部 あさひ銀行 吉祥寺支店 東京三菱銀行 新宿中央支社 常陽銀行 土浦支店 関東銀行 本店営業部		

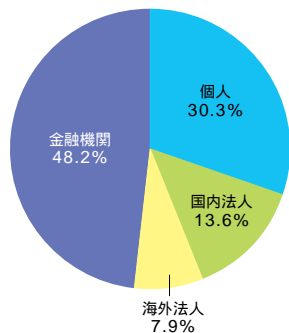
株価の推移 (平成14年9月30日現在)



株式の状況 (平成14年9月30日現在)

会社が発行する株式の総数	110,501,100株
発行済株式の総数	37,372,993株
株主数	26,527名

所有者別状況



大株主

株主名	持株数(千株)	出資比率(%)
UFJ信託銀行株式会社	2,935	7.8
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	2,636	7.0
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	2,502	6.6
野村信託銀行株式会社(投信口)	2,120	5.6
株式会社みずほコーポレート銀行	1,608	4.3
日本精工株式会社	1,313	3.5
株式会社損害保険ジャパン	1,100	2.9
三井生命保険相互会社	1,100	2.9
財団法人精密測定技術振興財団	1,058	2.8
高城 ヒデ子	808	2.1

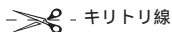
UFJ信託銀行株式会社の持株数には、信託業務分1,417千株が含まれております。

<株主の皆様へ アンケートのお願い>

弊社では、株主の皆様の声を経営に反映させるべく、アンケートを実施させていただいております。お手数ではございますが、アンケートの質問事項をお読みいただき、回答をご記入の上、ご投函下さい。皆様のご協力をお願い申し上げます。

<弊社資料請求について>

弊社資料をご希望の場合は、アンケート用紙の資料請求欄にご記入の上、ご投函下さい。



- キリトリ線 -

株主の皆様へ アンケートのお願い

1. 弊社の株式をご購入された理由は何でしょうか?

- 1) 将来性 2) 収益性 3) 経営理念 4) 事業内容 5) 証券会社に勧められて
6) その他()

2. 今後の弊社株式についてどのような方針をお持ちですか?

- 1) 買い増し 2) 保有 3) 売却

また、上記方針を決定するための判断材料は何ですか?

- 1) 株価 2) 配当 3) 将来計画 4) 業績 5) その他()

3. 今回の事業報告書で興味を持たれた記事はどれでしょうか?

- 1) 株主の皆様へ 2) FAQ 3) 新製品情報 4) 営業の概況
5) 財務データ 6) その他()

4. 今後事業報告書で取り上げて欲しいテーマをお聞かせ下さい。

()

5. 株式投資歴をお聞かせ下さい。

- 1) 3年未満 2) 3年以上10年未満 3) 10年以上20年未満 4) 20年以上

6. 所有株式数をお聞かせ下さい。

- 1) 100株 2) 200株以上 3) 500株以上 4) 1,000株以上 5) 5,000株以上

7. 弊社株式保有歴をお聞かせ下さい。

- 1) 1年未満 2) 1年以上 3) 3年以上 4) その他()

8. その他、弊社に対するご意見・ご希望があればお願いいたします。

()

資料請求(ご希望の資料に丸印をお願いします)

- 1) 会社概要 2) 和文版アニュアルレポート 3) 英文版アニュアルレポート
4) LEEPL社 会社案内

ご住所 〒

お名前

男性・女性

年齢

株主メモ

決算期 毎年3月31日
定時株主総会 毎年6月中 基準日毎年3月31日
その他必要あるときは、あらかじめ基準日を公告いたします。
名義書換代理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号
UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱所 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話(03)5683-5111(代表)
同取次所 UFJ信託銀行株式会社
株式取扱手数料 名義書換 無料
新株券交付 無料
公告掲載新聞 東京都において発行される日本経済新聞

✂ - キリトリ線 -

郵便はがき

料金受取人払

三鷹局承認

285

差出有効期限
平成15年4月
30日まで

1 8 1 8 7 9 0

東京都三鷹市下連雀9-7-1

株式会社 東京精密
業務会社 総務室 宛



東京精密ホームページ

<http://www.accretech.jp>



「投資家の皆様へ」をクリック



IRホームページ

<http://www.accretech.jp/contents/ir.html>

最新のプレスリリース掲載

アニュアルレポート、事業報告書等
各種IRツールのダウンロードが可能
な充実したIRライブラリー

決算短信、主要財務指標掲載

決算説明会の状況をオンデマンド
配信(決算説明会後3ヶ月間)

TOKYO SEIMITSU
<http://www.accretech.jp>